

2021年度 第4四半期 決算説明資料

2022.4.21

将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

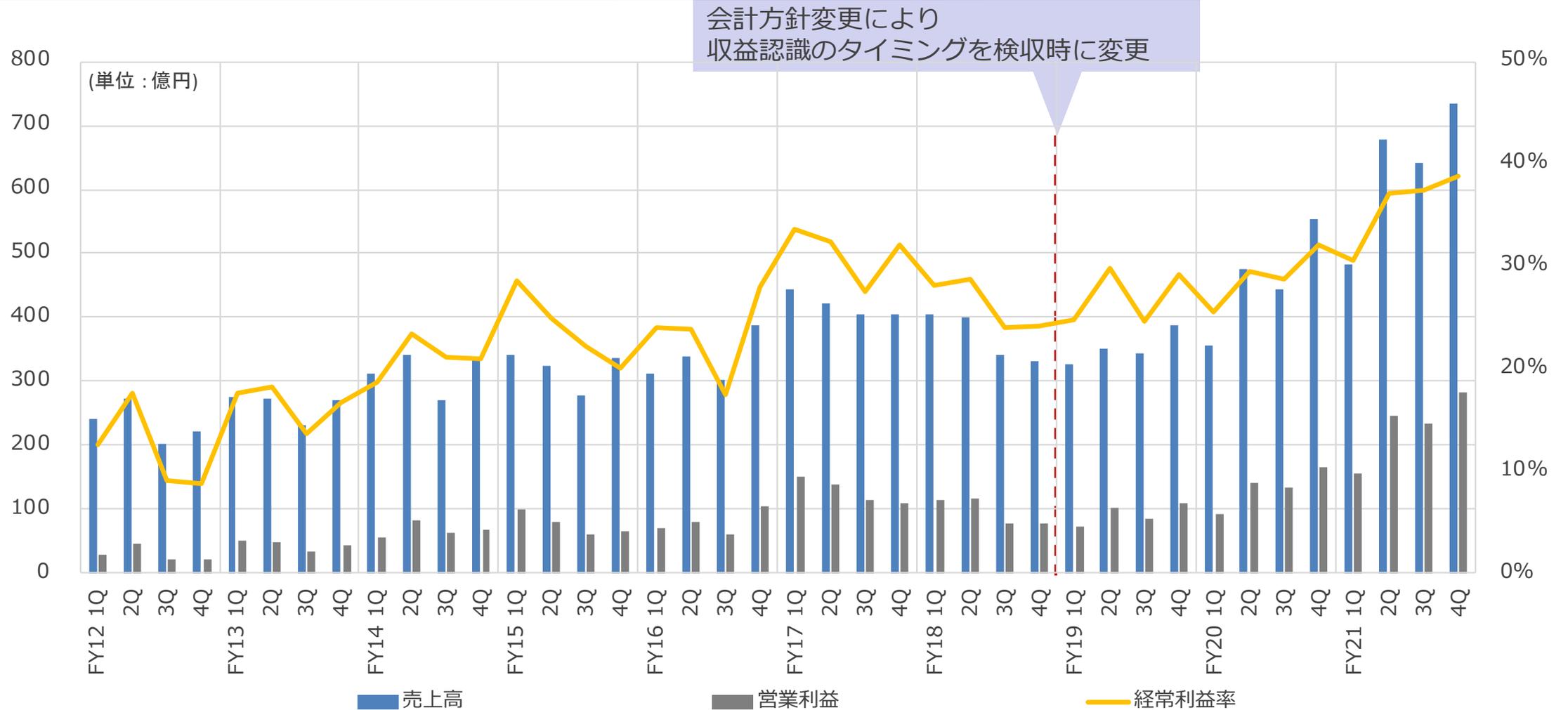


(単位：百万円)	FY2021	FY2021	QoQ		FY2020	YoY	
	4Q	3Q	差額	(%)	4Q	差額	(%)
売上高	73,512	64,186	9,326	14.5%	55,248	18,264	33.1%
売上総利益	45,010	39,157	5,854	14.9%	31,412	13,599	43.3%
GP率	61.2%	61.0%	0.2p	-	56.9%	4.3p	-
販売管理費	16,747	15,865	882	5.6%	14,978	1,769	11.8%
営業利益	28,263	23,292	4,971	21.3%	16,433	11,830	72.0%
経常利益	28,552	24,001	4,551	19.0%	17,742	10,810	60.9%
経常利益率	38.8%	37.4%	1.4p	-	32.1%	6.7p	-
税前利益	28,514	23,901	4,612	19.3%	17,689	10,824	61.2%
純利益	20,697	16,916	3,780	22.3%	13,464	7,233	53.7%

売上高： 高水準の出荷と検収の進捗によりQoQ、YoYともに増加（過去最高更新）
 GP率： 為替影響及び改善活動（原価低減や付加価値増）等により上昇
 販売管理費： 主に業績連動費用が増加

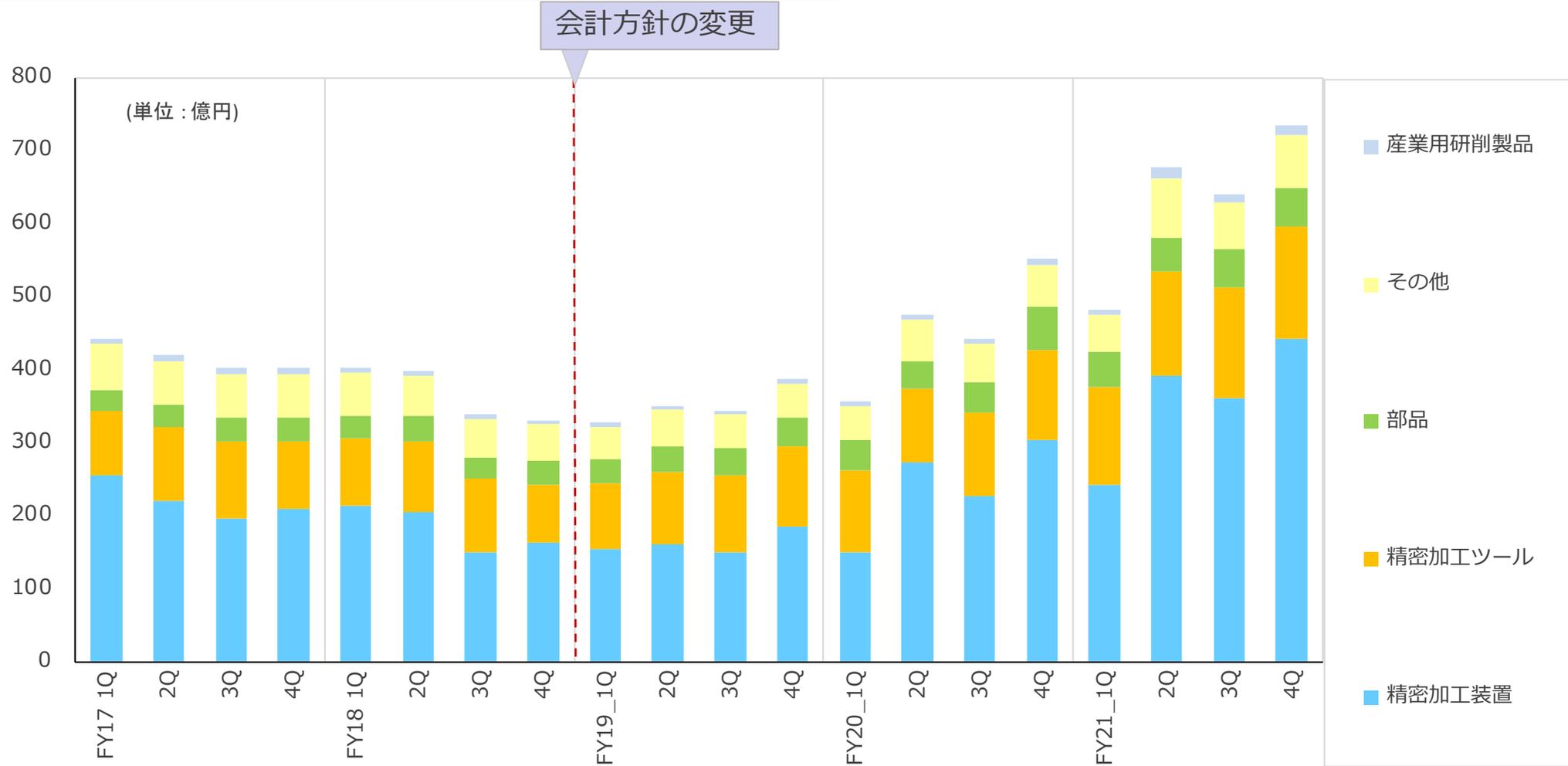
(単位：百万円)	FY2021 Full Year	FY2020 Full Year	YoY	
			差額	(%)
売上高	253,781	182,857	70,924	38.8%
売上総利益	154,011	106,883	47,128	44.1%
GP率	60.7%	58.5%	2.2p	-
販売管理費	62,498	53,776	8,721	16.2%
営業利益	91,513	53,106	38,407	72.3%
経常利益	92,449	53,629	38,820	72.4%
経常利益率	36.4%	29.3%	7.1p	-
税前利益	92,251	53,434	38,817	72.6%
純利益	66,206	39,091	27,115	69.4%

売上高： 好調な製品出荷を背景に、検収売上も伸長（過去最高更新）
 GP率： 為替影響や改善活動（原価低減や付加価値増）等により上昇
 販売管理費： 主に業績連動費用が増加



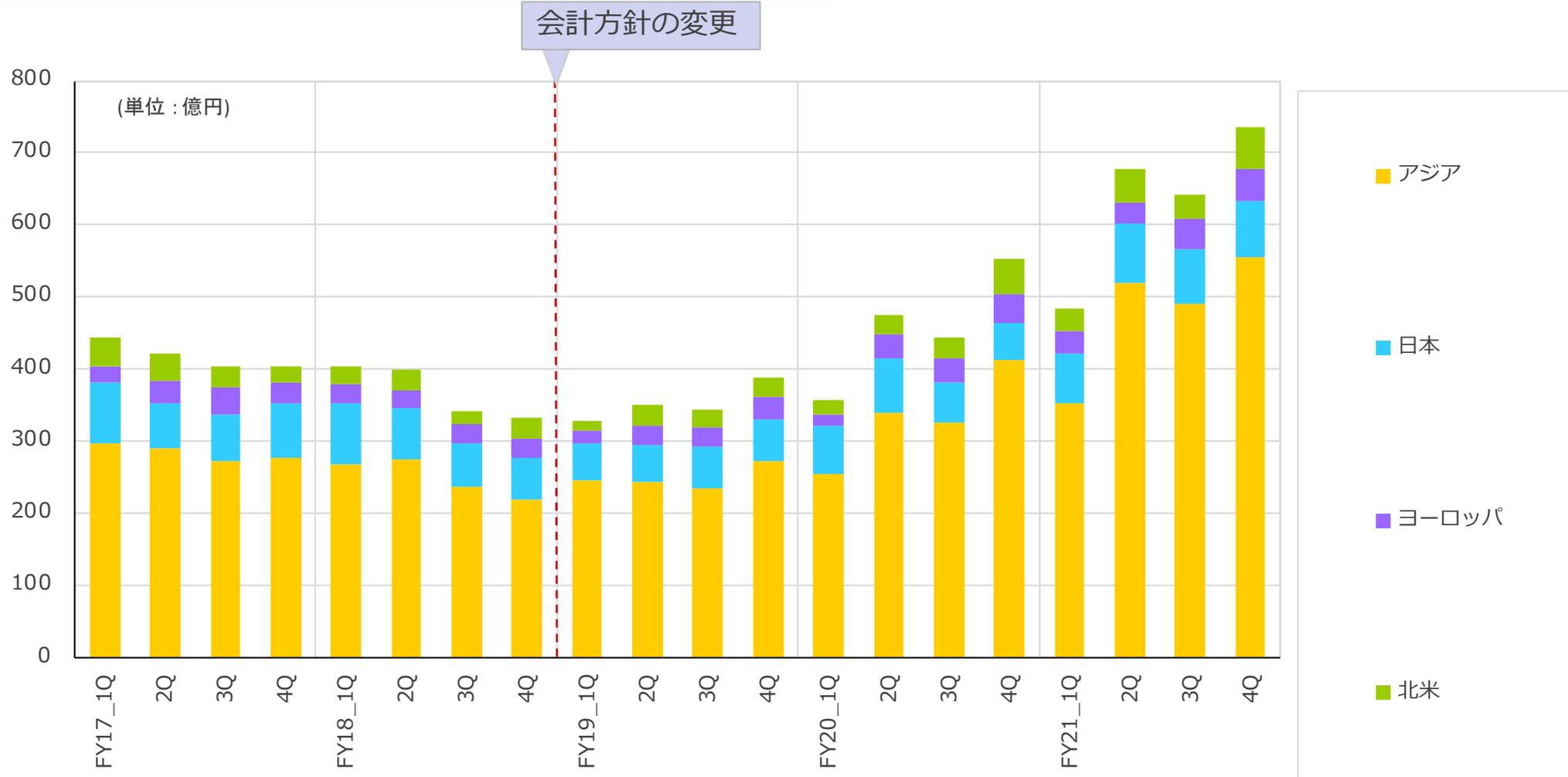
四半期ベースの業績および各利益率はいずれも過去最高を更新
 (FY21_4Q 営業利益率38.4% 経常利益率38.8% 純利益率28.2%)

製品群別売上高 四半期推移



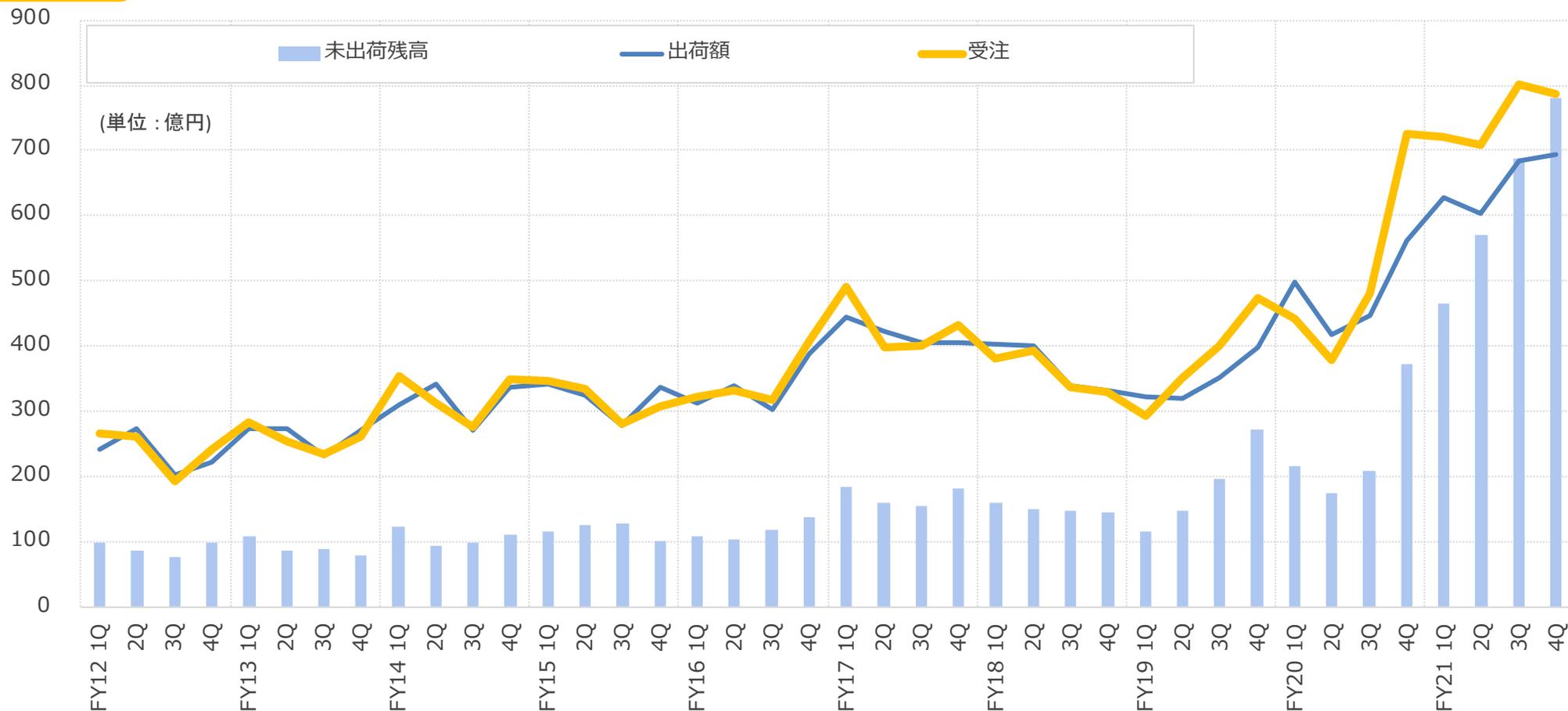
※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

地域別売上高 四半期推移



FY21_4Q 海外売上高比率 89.4%

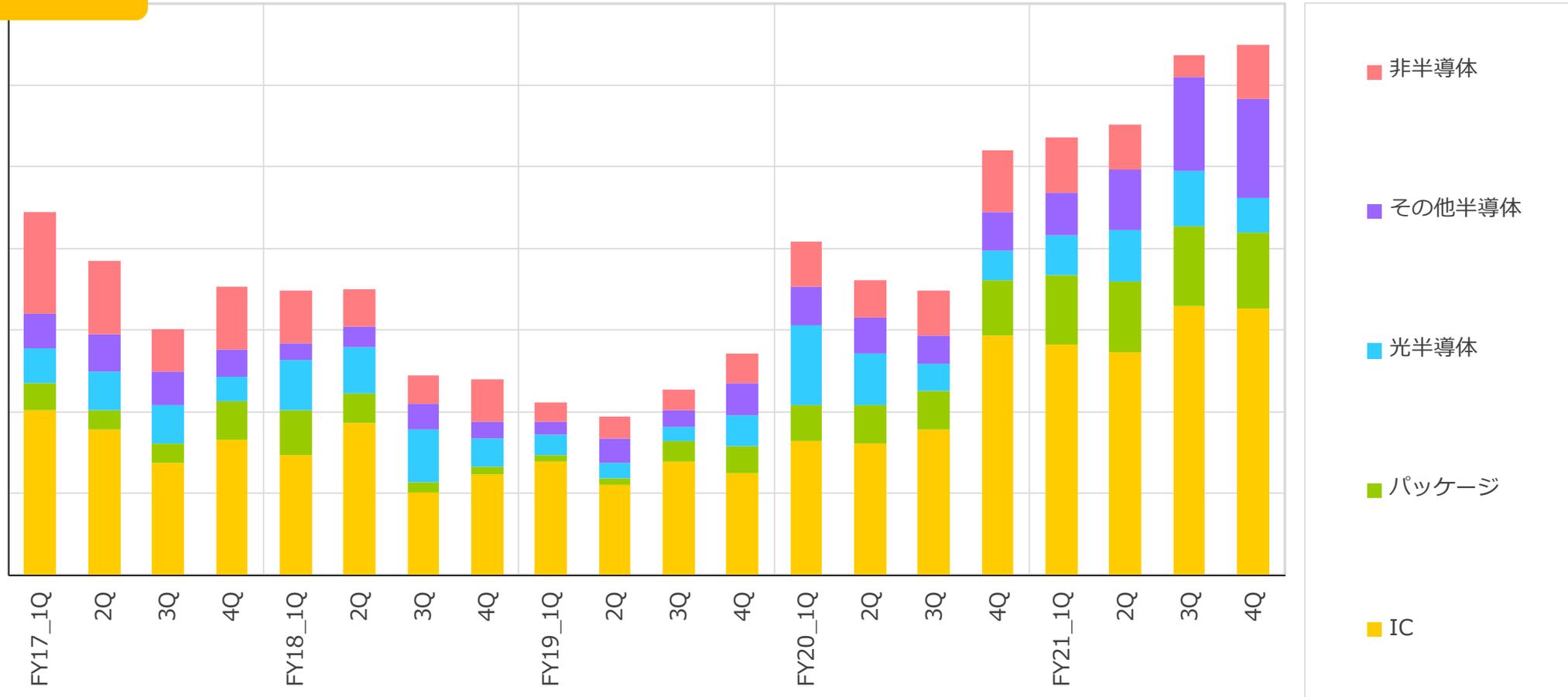
出荷額ベース



FY21_4Q 受注高 約785億円、出荷額 約693億円、未出荷残高 約778億円

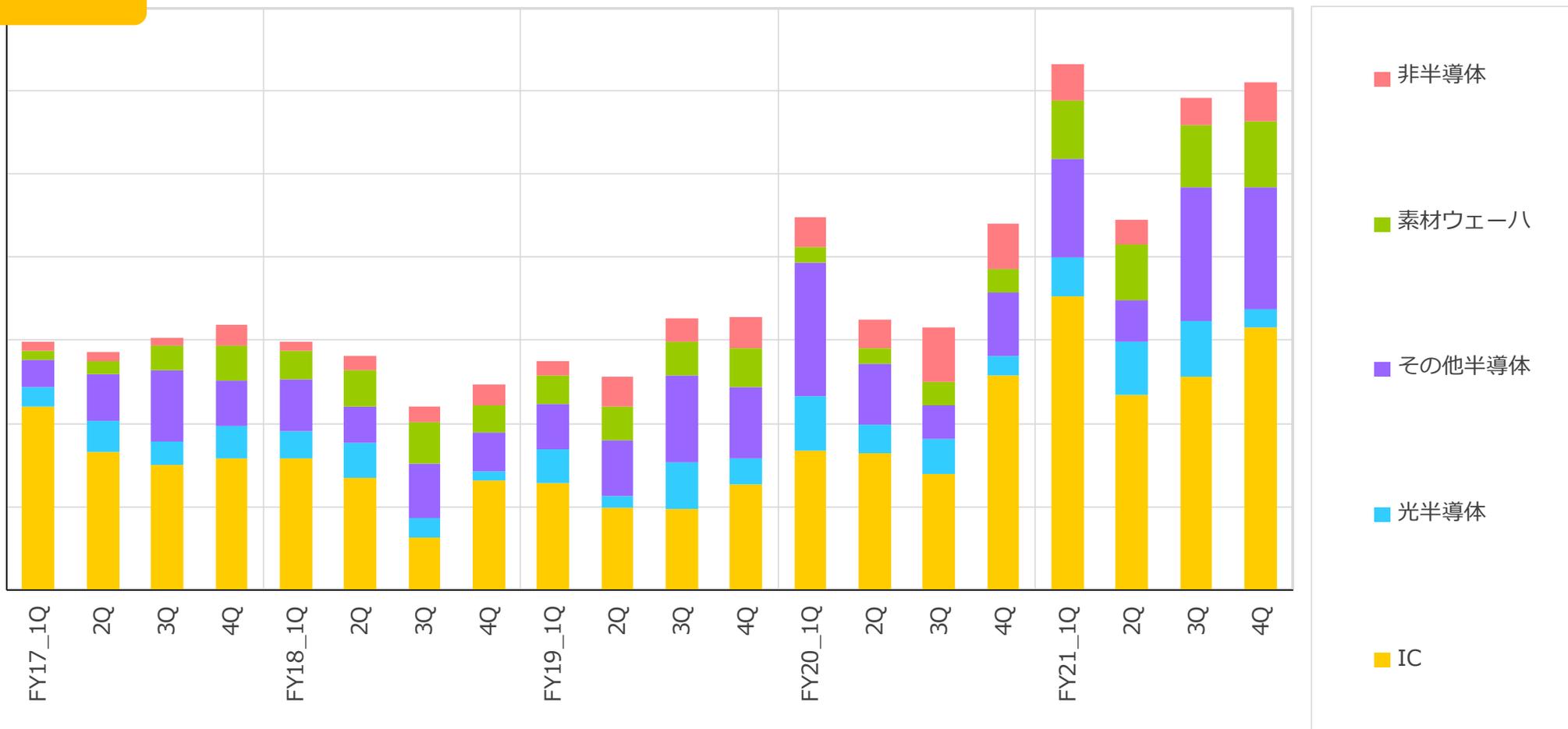
※「受注高・受注残高」開示は、今回の開示をもって終了

出荷額ベース



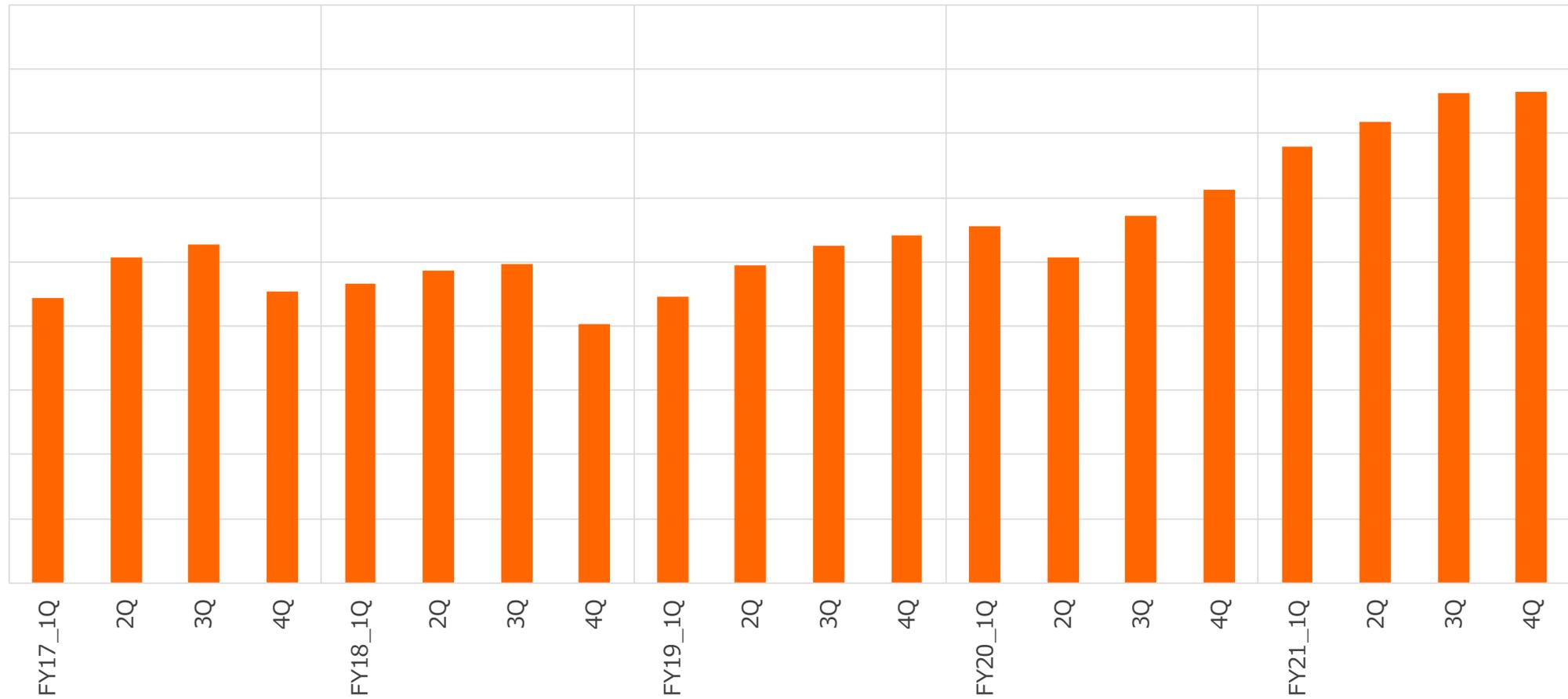
QoQ 好調なIC、パワー半導体向けに加え、非半導体の伸びが全体を押し上げた
 YoY 幅広い用途で半導体需要が拡大

出荷額ベース



QoQ メモリを中心としたIC向けが全体を押し上げた

YoY パワー半導体、素材ウェーハ向けなど幅広い用途で半導体需要が拡大



高い設備稼働率などを背景に消耗品の出荷は堅調

(単位：百万円)	FY2021 4Q	FY2021 3Q	差額
現金及び預金	125,771	130,217	-4,447
受取手形・売掛金	38,689	36,324	2,365
たな卸資産	68,479	66,656	1,823
流動資産	244,633	241,376	3,257
有形固定資産	144,427	117,295	27,132
固定資産	159,906	130,403	29,503
総資産	404,540	371,780	32,760
流動負債	109,851	99,579	10,272
固定負債	876	714	163
負債合計	110,728	100,293	10,435
純資産	293,812	271,486	22,325
負債純資産合計	404,540	371,780	32,760
自己資本比率	72.3%	72.7%	-0.4p

総資産：不動産取得（羽田R&Dセンター）により固定資産を中心に増加

負債：賞与引当や未払い法人税などが増加

純資産：主に利益剰余金の増加によるもの

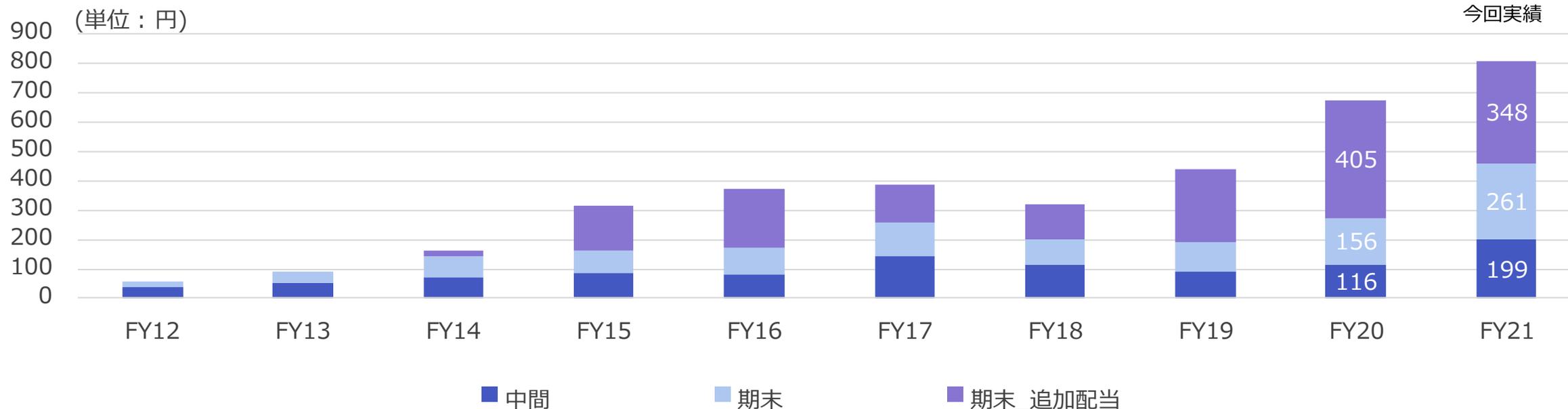
(単位: 百万円)	FY2021 Full Year	FY2020 Full Year	差額
営業キャッシュ・フロー	83,654	56,709	26,945
税前当期利益	92,251	53,434	38,817
減価償却	8,551	6,815	1,736
売上債権の増減	-2,923	-6,058	3,135
たな卸資産の増減	-9,594	-3,825	-5,770
仕入債務の増減	6,476	6,412	64
法人税支払い	-21,182	-6,860	-14,322
その他営業CF	10,075	6,789	3,286
投資キャッシュ・フロー	-43,591	-13,107	-30,485
有形固定資産の取得	-43,576	-21,026	-22,550
その他投資CF	-15	7,919	-7,935
フリー・キャッシュ・フロー	40,062	43,602	-3,540
財務キャッシュ・フロー	-27,193	-15,825	-11,368
配当金支払い	-27,401	-16,653	-10,748
現金同等物増減	15,961	30,026	-14,065
期首残高	109,809	79,782	30,027
期末残高	125,771	109,809	15,962

- 営業CF・・・約836億円 資金増加
主に税前利益による資金増加
 - 投資CF・・・約439億円 資金減少
主に羽田R&Dセンターや桑畑工場の新
棟建設などによる支払い
 - フリー・キャッシュ・フロー
約436億円の資金増加
 - 財務CF・・・約274億円 資金減少
主に配当金の支払い
- 3月末の現金残高 約1,257億円

【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 期末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

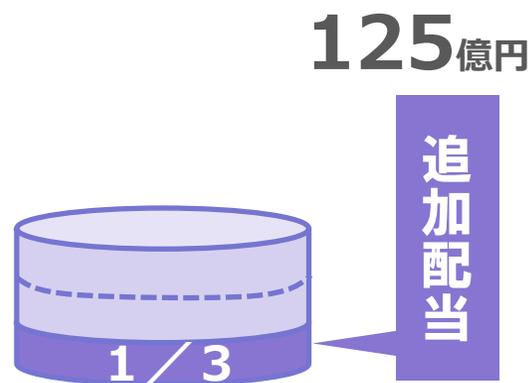
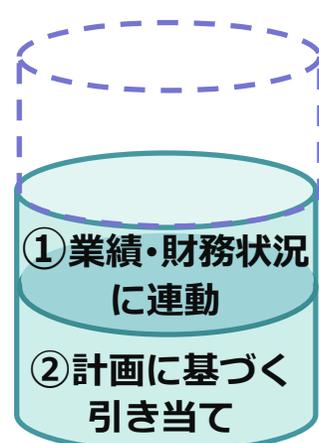
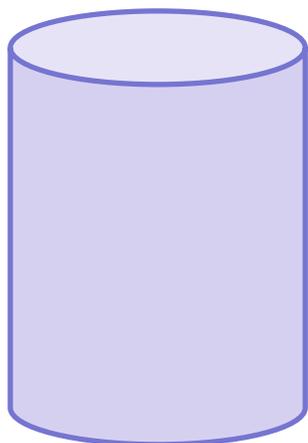
*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



FY21 中間（実績）199円
 期末（実績）609円 内訳：業績連動261円 追加配当348円
 年間（実績）808円

今回実績

期末現預金 1,048 億円 ※1	-	必要資金 673 億円	=	余剰資金 375 億円
------------------------------------	---	------------------------------	---	------------------------------



必要資金の内訳

①	運転資金 <small>〔 前期連結売上高 ÷ 12ヶ月 × 2ヶ月 〕</small>	423 億円
①	技術購入予備費(M&A含む) <small>〔 連結売上高 過去3年平均 × 10% 〕</small>	6 億円 ※2
	長期有利子負債返済資金	-
	税金・配当等	191 億円
②	設備拡張資金 <small>〔 オフィス拡張等 〕</small>	53 億円

※1 契約負債（前受金）金額および羽田R&Dセンター支払い分などを考慮
 ※2 羽田R&Dセンター取得は技術関連支出のため、技術購入予備費枠を使用

(単位：億円)

今回予想

	FY21 1Q	2Q	3Q	4Q	FY22 1Q
売上高	483	678	642	735	624
営業利益	154	245	233	283	222
経常利益	148	251	240	286	223
純利益	106	180	169	207	157
営業利益率	32.0%	36.2%	36.3%	38.4%	35.6%
経常利益率	30.5%	37.1%	37.4%	38.8%	35.7%
純利益率	21.9%	26.6%	26.4%	28.2%	25.2%
出荷額	627	604	684	694	683

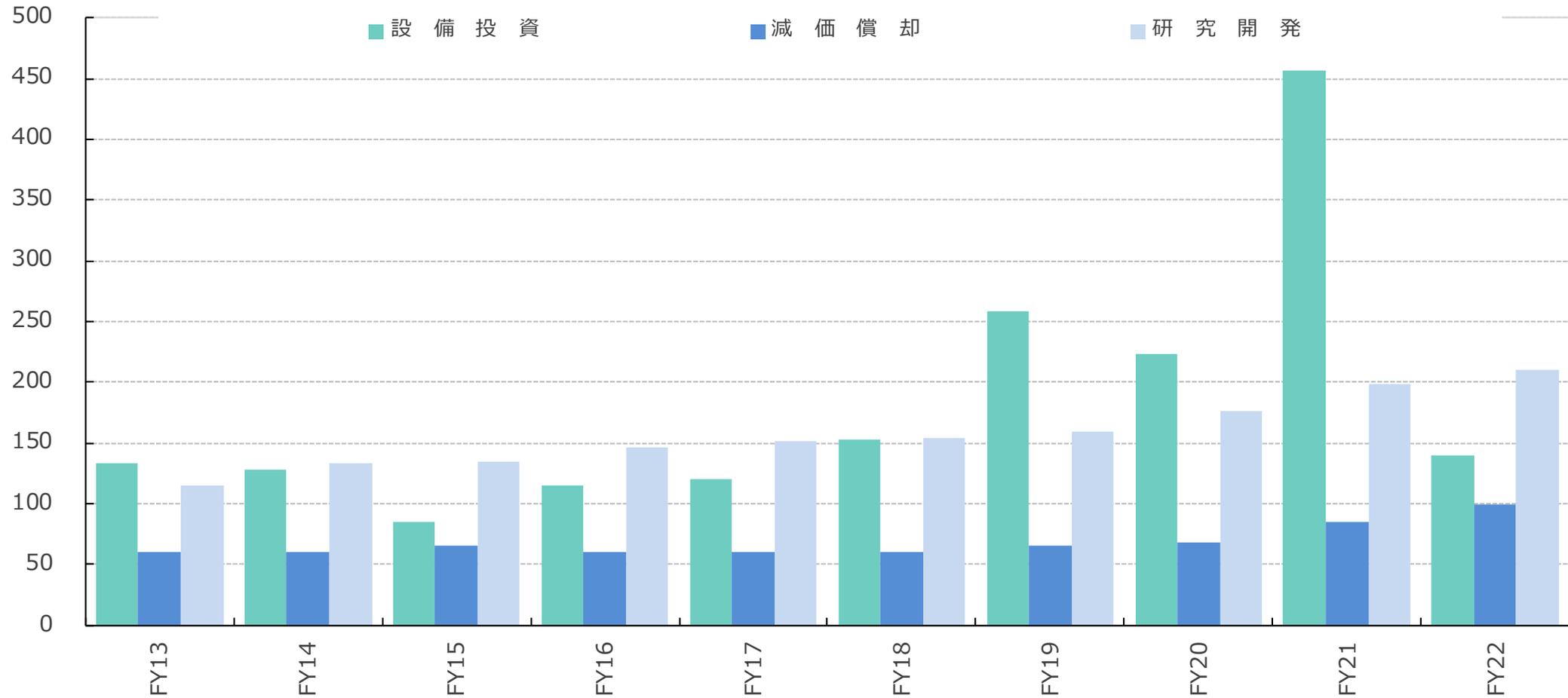
※億円未満 四捨五入

想定為替レート
為替感応度（年換算）

US\$: 115円 Euro : 125円
US\$: 約12億円 Euro : 約3千万円

出荷額ベース

製品群		見通し FY22_1Q 増減率 (QoQ)
	ブレードダイサ	-10%
	レーザソー	横ばい
ダイサ		-7%
	薄化DGP	20%
	薄化以外	5%
グラインダ		15%
精密加工装置		横ばい
精密加工ツール		横ばい
その他		-10%

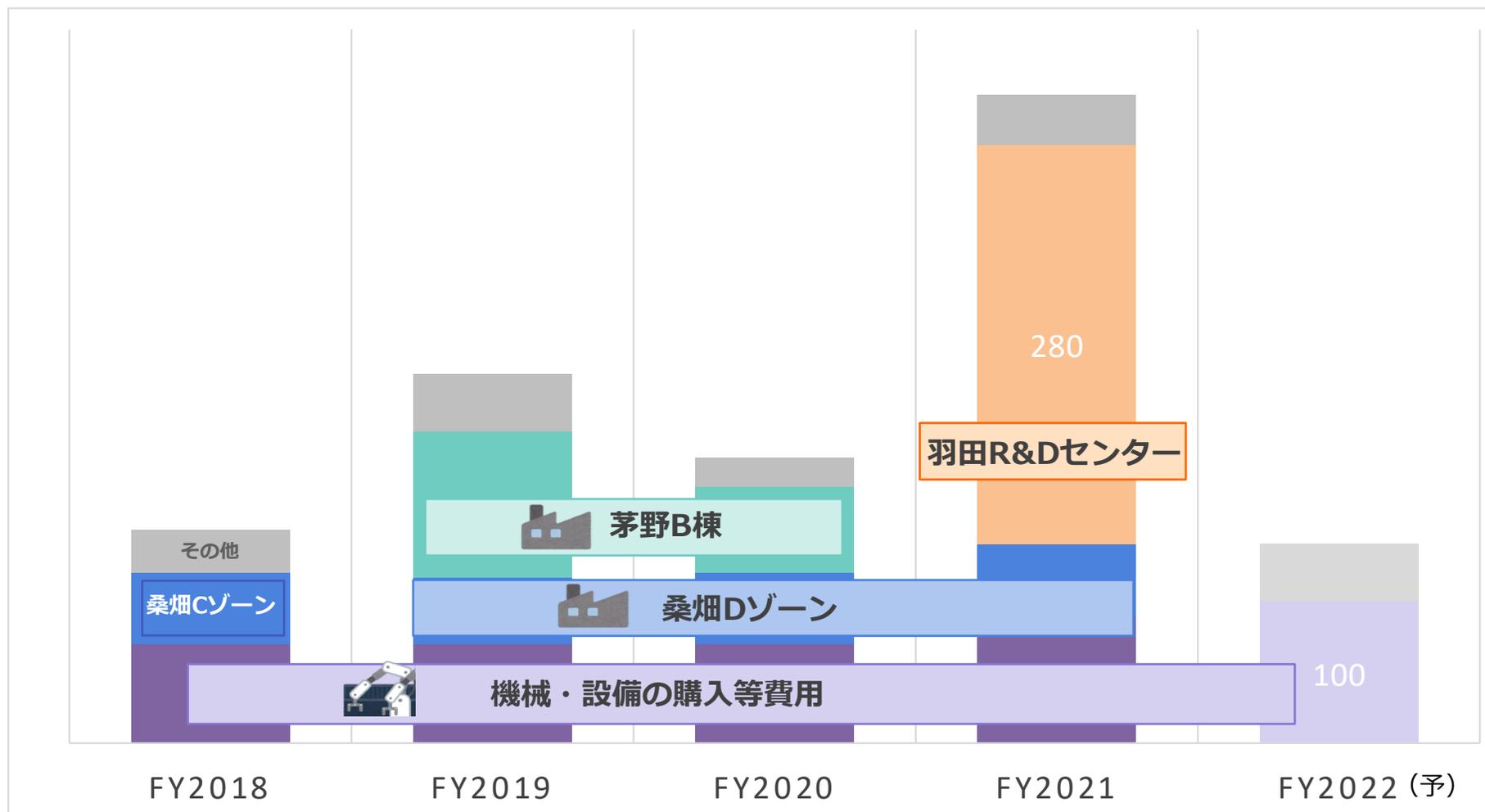


見通し

FY22見通し 設備投資：合理化投資を中心に実施
 減価償却：前年度取得資産の償却
 研究開発：積極的な研究開発を予定

140億円程度 (FY21実績 456億円)
 100億円前後 (FY21実績 85億円)
 210億円前後 (FY21実績 198億円)

単位：億円



FY22見通し

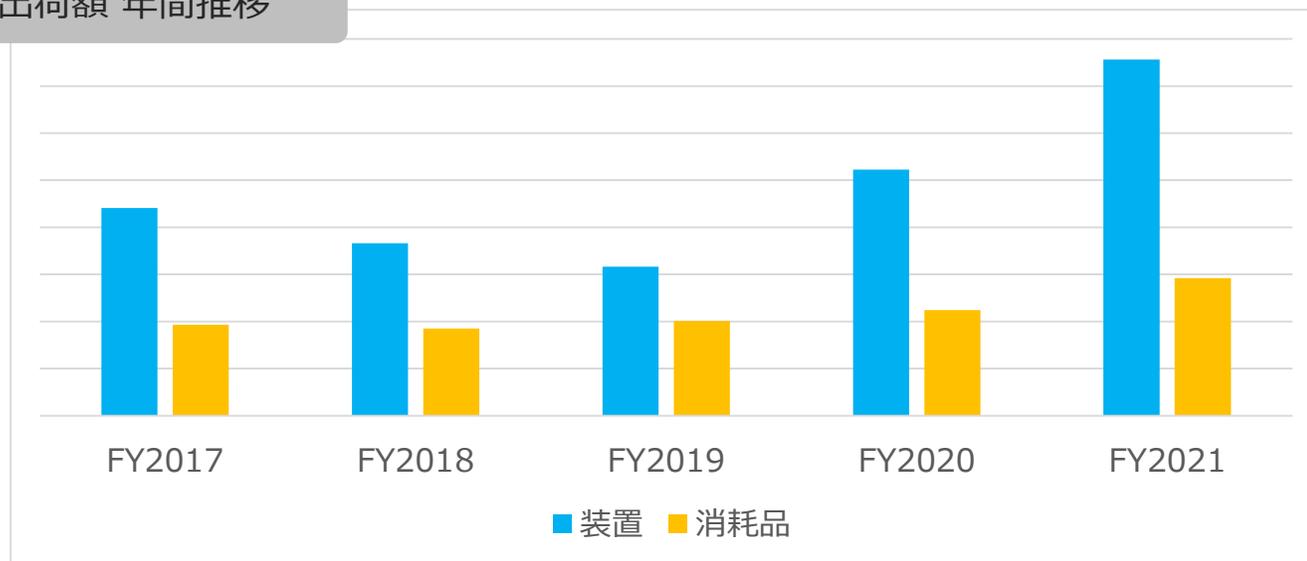
機械・設備の購入等費用
他 オフィス拡張など

約100億円
約40億円

■ 出荷動向

感染対策を継続しつつ、生産キャパを継続的に強化
 (工場拡張、製造支援・人財採用、改善活動)
 装置、消耗品、共に過去最高を大幅に更新

出荷額 年間推移

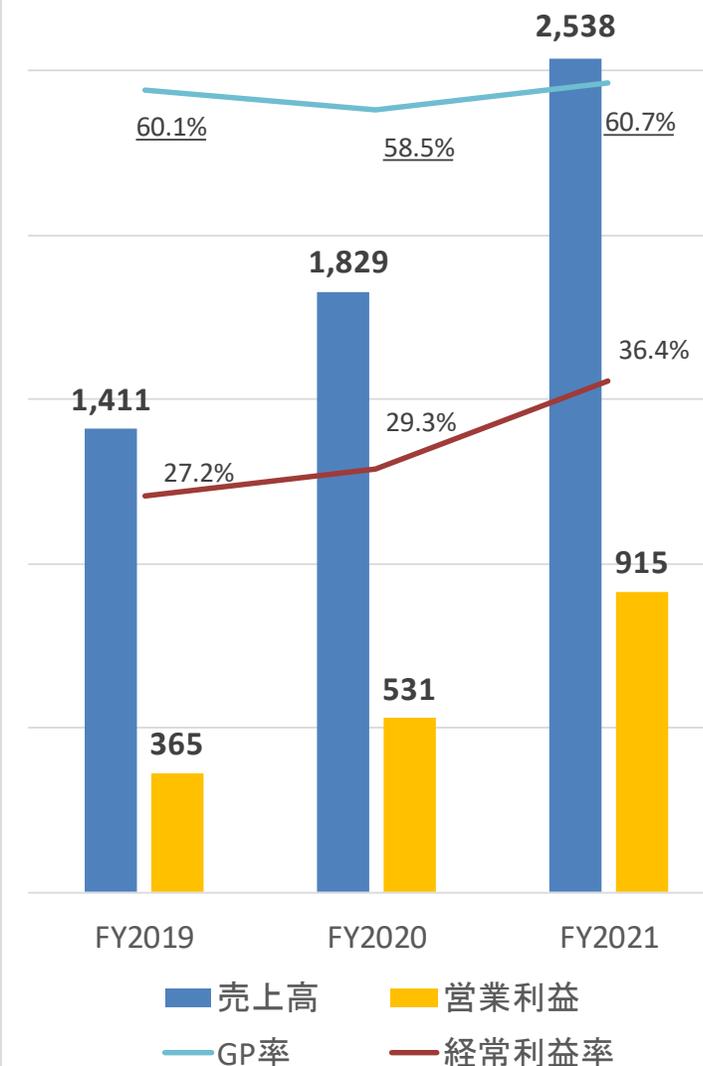


■ 2期連続最高益 収益性も向上

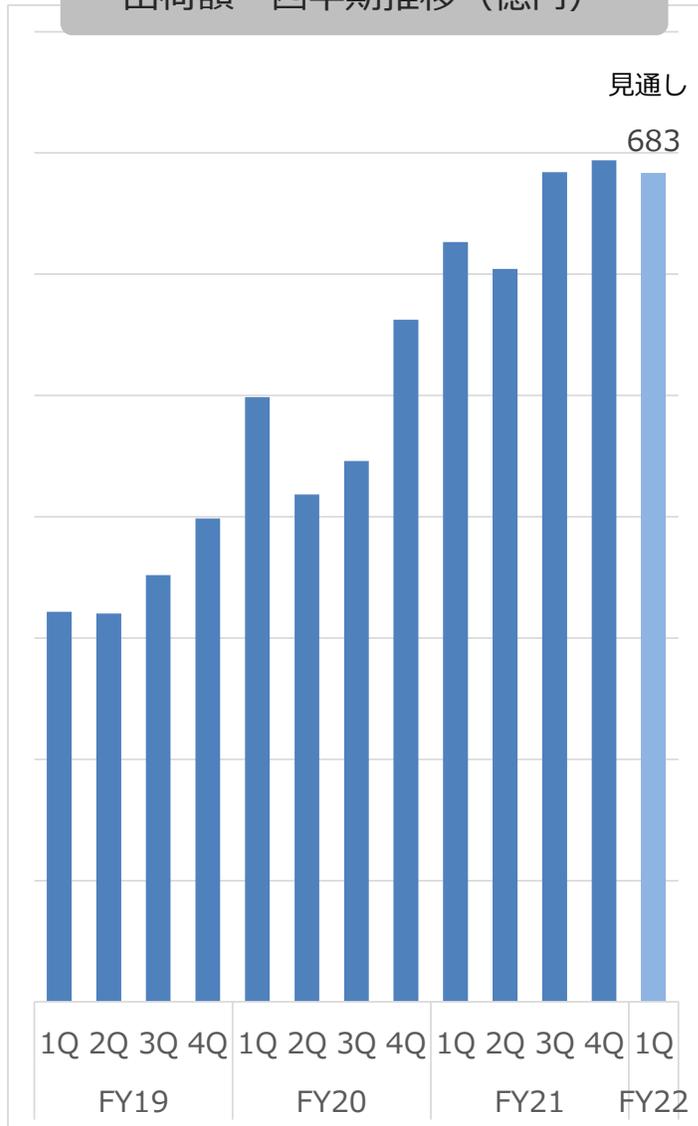
改善活動に加え良好な市場環境も追い風にGP率は高水準

■ 業績連動と余剰資金からの配当により増配 (年間808円 ※前年677円)

年間推移 (検収基準) 単位: 億円



出荷額 四半期推移 (億円)



- 引き続き幅広い用途で需要堅調（ロジック、メモリ、パワー他）
出荷額は高水準継続を見込む

- 「変化への対応力」を継続して強化
 - ・ 生産能力・生産性の向上
→工場新棟竣工、人財採用強化（工場はフル稼働継続）
PIM活動による改善（原価低減と付加価値増）
 - ・ 開発力の強化：羽田R&Dセンター開設

- ガバナンス体制を「指名委員会等設置会社」へ移行

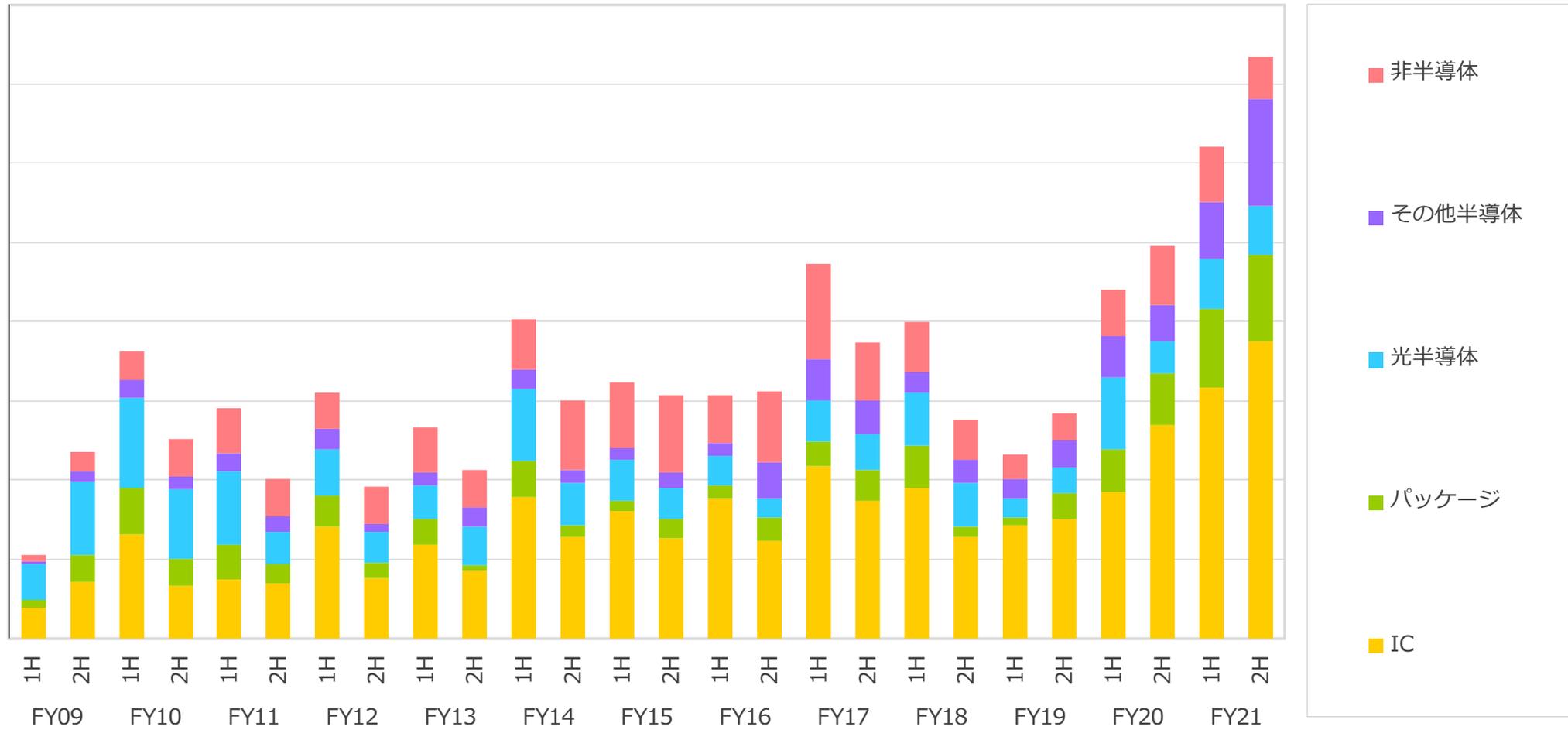
- 「DISCO VISION 2030」策定およびサステナビリティ課題を特定
DISCO VALUES、Will会計、PIM活動など通じて
「会社を強くする」と「社会問題解決」への取り組みを継続・強化

- 【ご参考】 半期・通期推移 グラフ集

ダイサ用途別売上高(単体)

出荷額ベース

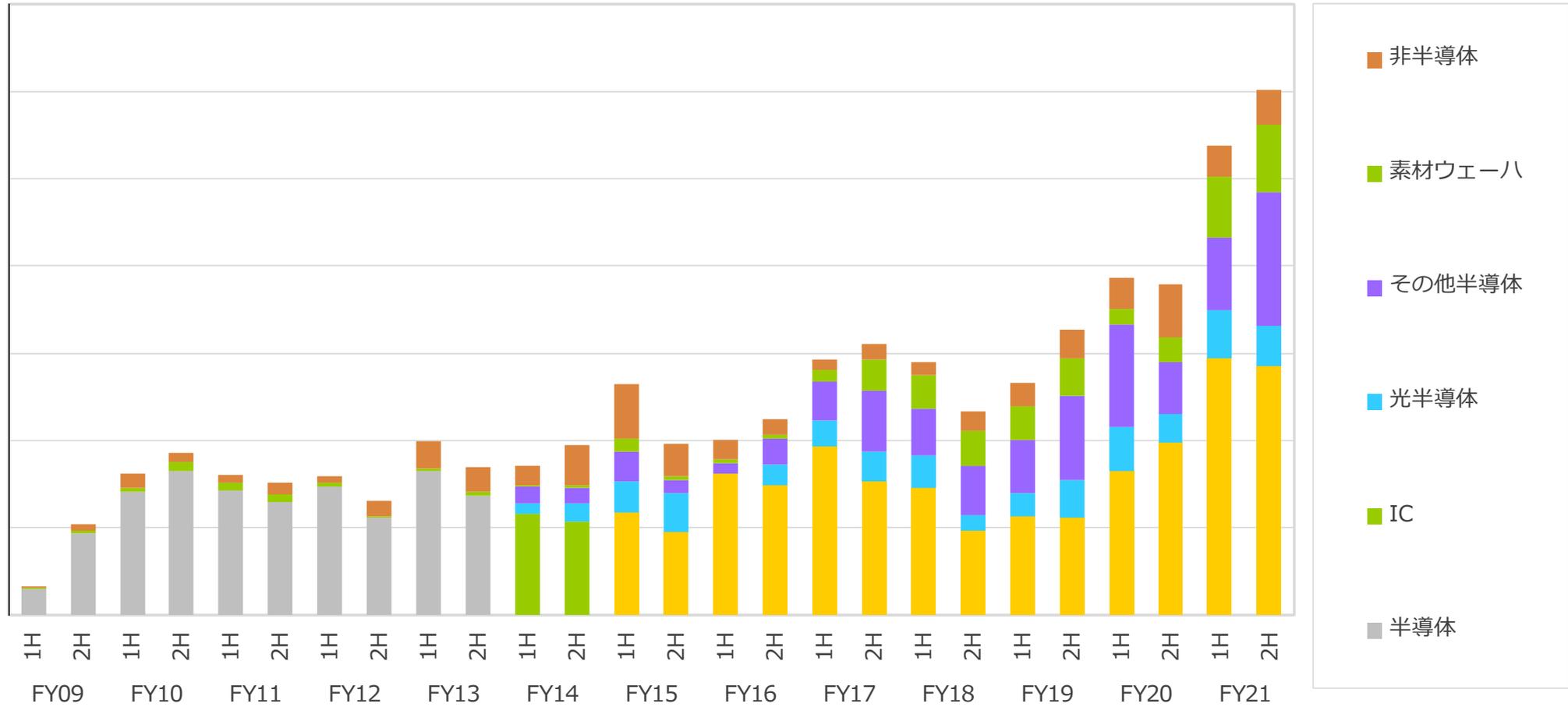
半期



グライнда用途別売上高(単体)

出荷額ベース

半期



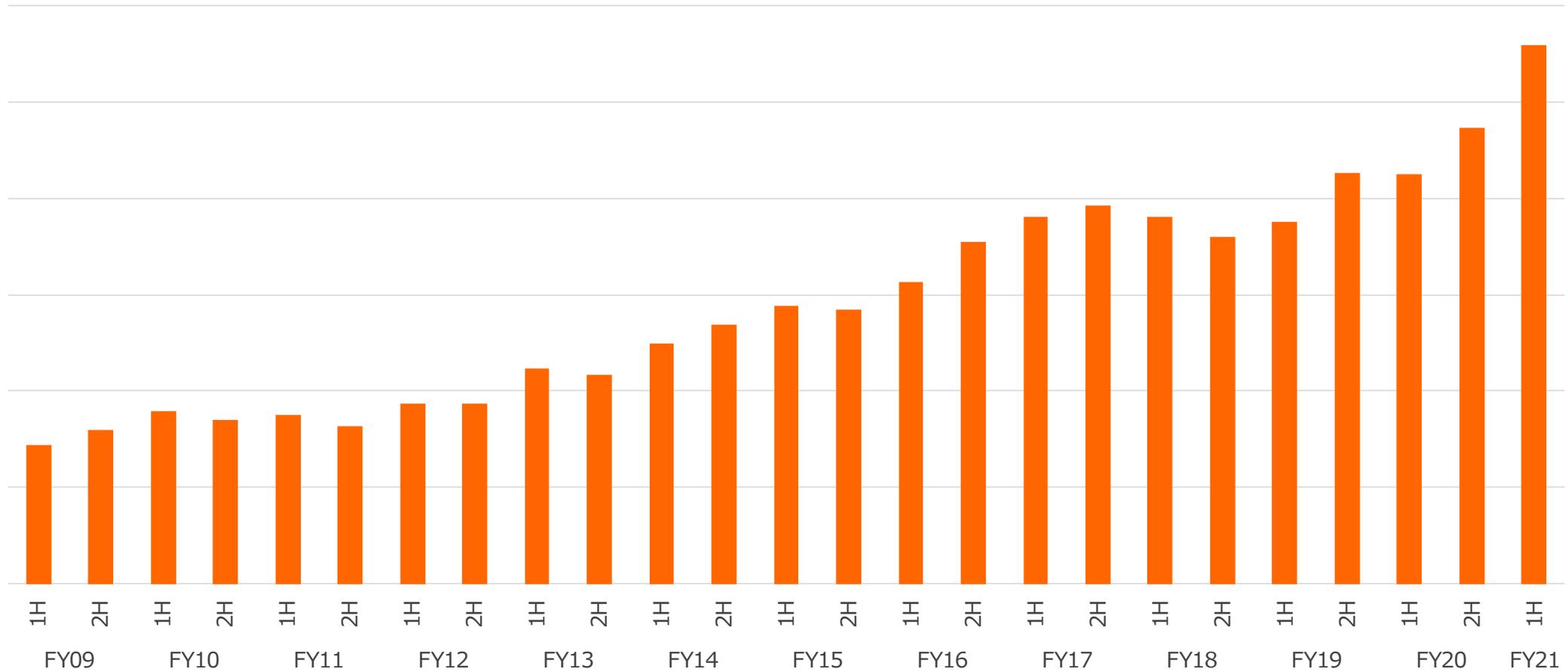
※FY14 1Qよりカテゴリを変更

『半導体』 → 『IC』 + 『光半導体』 + 『その他半導体』

『電子部品』 → 『非半導体』

出荷額ベース

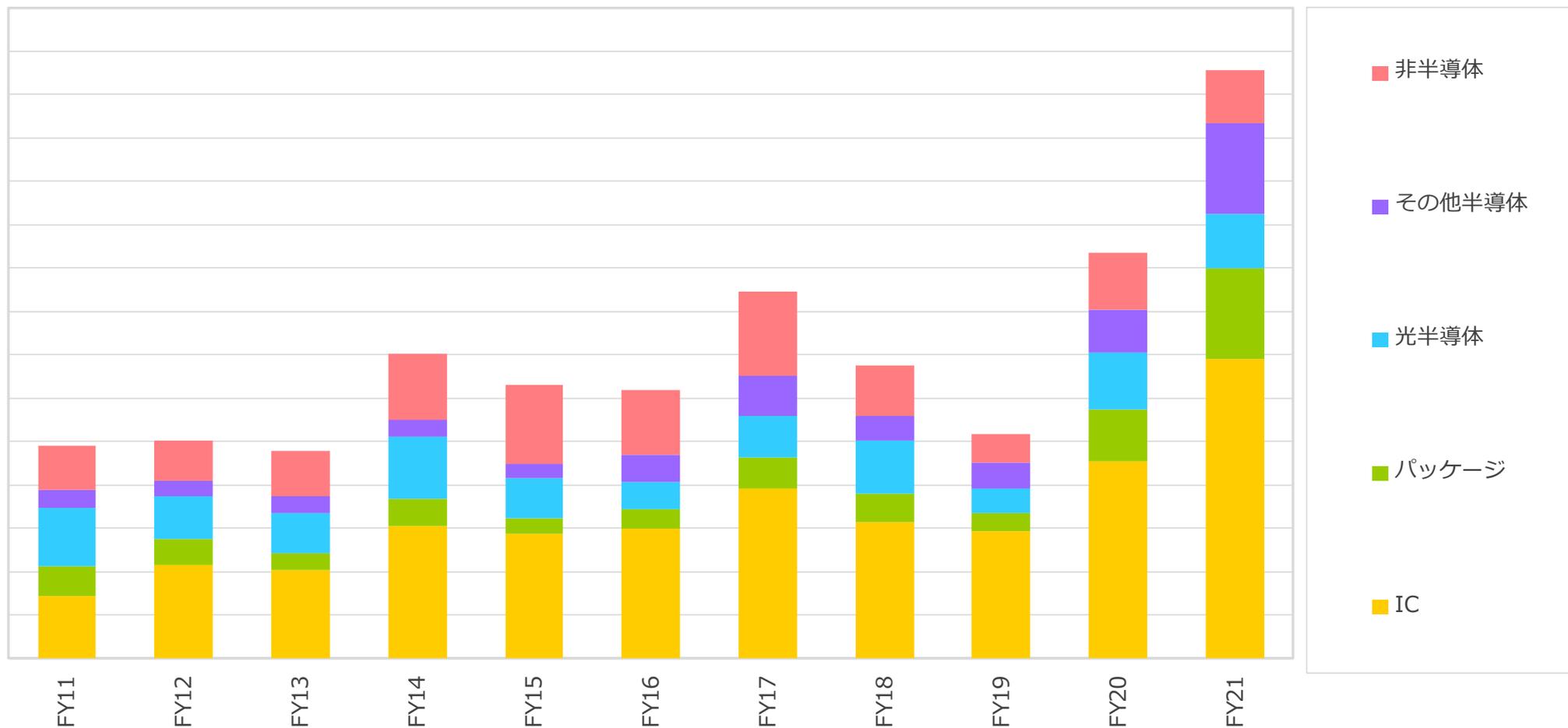
半期



ダイサ用途別売上高(単体)

出荷額ベース

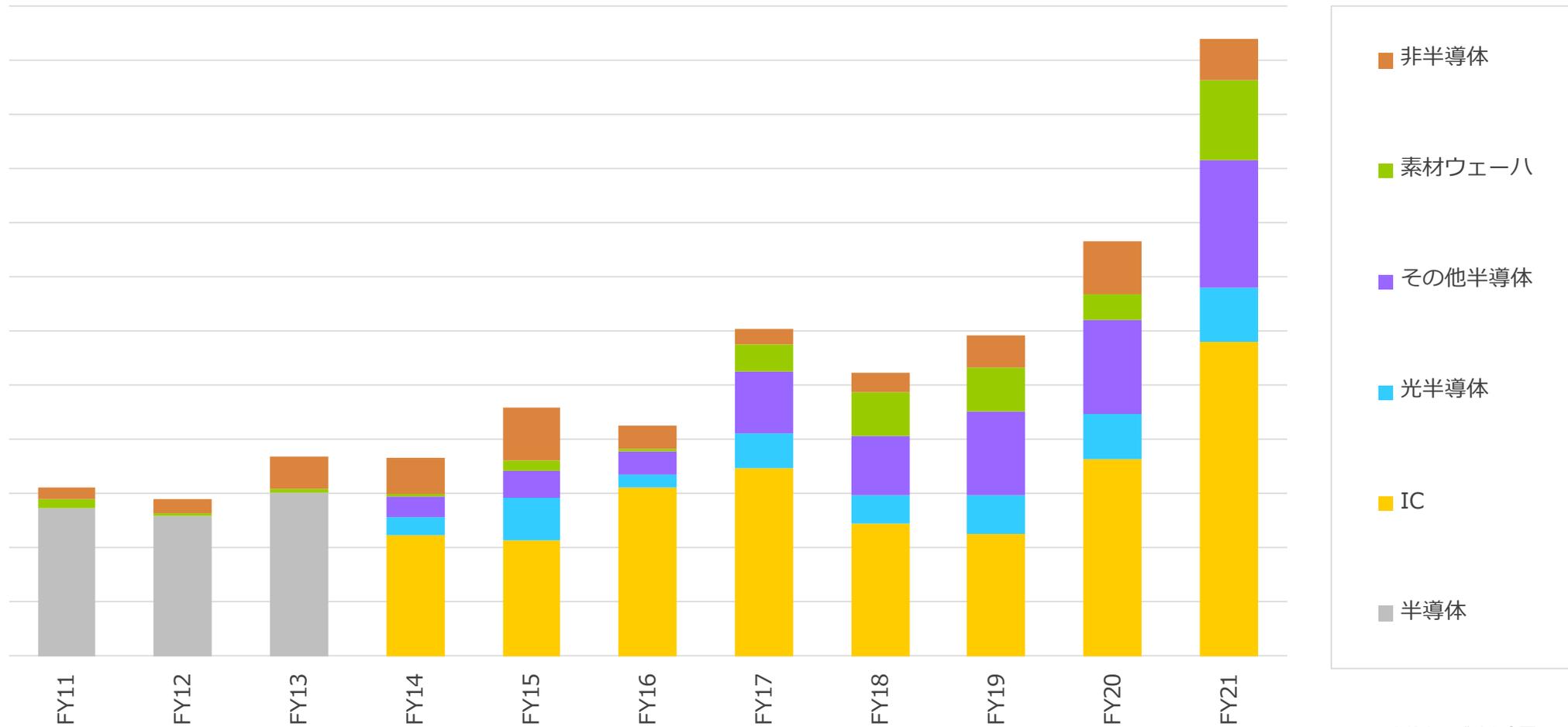
通期



グライнда用途別売上高(単体)

出荷額ベース

通期



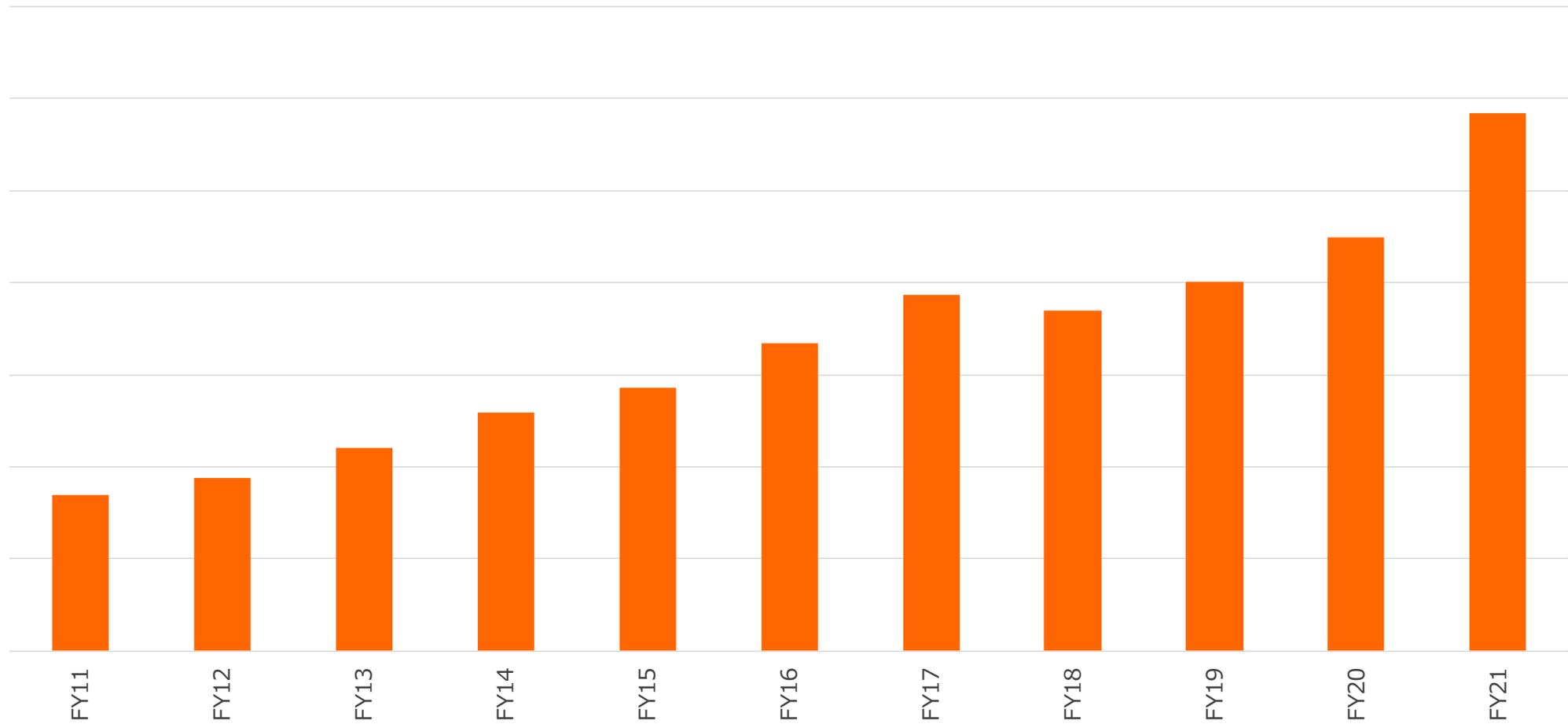
※FY14 よりカテゴリを変更

『半導体』 → 『IC』 + 『光半導体』 + 『その他半導体』

『電子部品』 → 『非半導体』

出荷額ベース

通期



- ご参考 製品群別 用途別 データ集

出荷額ベース

■ 製品群	構成比	QoQ	YoY	構成比	YoY	構成比	YoY
	4Q	4Q	4Q	2H	2H	Full Year	Full Year
精密加工装置合計	60%	5%	31%	59%	52%	58%	45%
装置の内ダイサ	41%	5%	29%	41%	52%	39%	45%
ブレードダイサ	26%	9%	35%	25%	52%	25%	50%
レーザソー	15%	-1%	21%	16%	52%	14%	38%
装置の内グラインダ	19%	4%	34%	18%	52%	19%	45%
薄化DGP	11%	-1%	26%	11%	46%	11%	41%
薄化以外	8%	11%	46%	8%	62%	8%	52%
精密加工ツール	22%	-1%	25%	22%	29%	22%	30%
その他	18%	-6%	3%	19%	10%	20%	18%
出荷額合計	100%	1%	23%	100%	37%	100%	35%

【ご参考】単体 用途別 構成比

出荷額ベース

構成比		2020年度				2021年度			
製品	用途	20-1Q	20-2Q	20-3Q	20-4Q	21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q
ダイサ	1_IC	40%	45%	51%	56%	53%	49%	52%	50%
	2_パッケージ	11%	13%	14%	13%	16%	16%	16%	14%
	3_光半導体	24%	17%	10%	7%	9%	11%	10%	7%
	4_その他_半導体	11%	12%	10%	9%	10%	13%	18%	19%
	5_非半導体	14%	13%	16%	14%	13%	10%	4%	10%
ダイサ		100%							
グライнда	1_IC	37%	51%	44%	58%	56%	53%	43%	52%
	2_光半導体	14%	11%	13%	5%	7%	14%	11%	4%
	3_その他_半導体	36%	22%	13%	17%	19%	11%	27%	24%
	4_素材ウエーハ	4%	6%	9%	6%	11%	15%	13%	13%
	5_非半導体	8%	11%	21%	13%	7%	7%	6%	8%
グライнда		100%							

出荷額ベース

YoY		2020年度				2021年度			
製品	用途	20-1Q	20-2Q	20-3Q	20-4Q	21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q
ダイサ	1_IC	18%	46%	28%	135%	73%	69%	85%	12%
	2_パッケージ	466%	442%	91%	104%	92%	83%	106%	37%
	3_光半導体	293%	231%	82%	-3%	-51%	1%	99%	14%
	4_その他_半導体	197%	52%	77%	18%	13%	70%	241%	156%
	5_非半導体	128%	66%	113%	109%	20%	17%	-51%	-10%
ダイサ		92%	85%	53%	91%	31%	52%	83%	25%
グライнда	1_IC	31%	67%	44%	103%	111%	43%	83%	22%
	2_光半導体	57%	156%	-25%	-23%	-30%	82%	64%	-3%
	3_その他_半導体	196%	8%	-62%	-11%	-26%	-32%	304%	91%
	4_素材ウエーハ	-44%	-55%	-29%	-40%	268%	268%	162%	184%
	5_非半導体	108%	-4%	131%	51%	19%	-16%	-50%	-15%
グライнда		63%	27%	-3%	35%	41%	37%	87%	38%

出荷額ベース

QoQ		2020年度				2021年度			
製品	用途	20-1Q	20-2Q	20-3Q	20-4Q	21-1Q	21-2Q	21-3Q	21-4Q
ダイサ	1_IC	32%	-2%	10%	64%	-3%	-4%	21%	-1%
	2_パッケージ	34%	7%	1%	42%	25%	2%	14%	-6%
	3_光半導体	154%	-36%	-47%	12%	29%	30%	5%	-35%
	4_その他_半導体	16%	-6%	-23%	40%	12%	41%	55%	5%
	5_非半導体	55%	-16%	19%	36%	-11%	-18%	-50%	148%
ダイサ		50%	-11%	-4%	49%	3%	3%	16%	2%
グライнда	1_IC	32%	-2%	-15%	84%	37%	-34%	9%	23%
	2_光半導体	109%	-46%	19%	-43%	92%	40%	6%	-66%
	3_その他_半導体	87%	-55%	-45%	91%	56%	-59%	228%	-10%
	4_素材ウエーハ	-59%	-4%	52%	0%	151%	-4%	9%	8%
	5_非半導体	-1%	-5%	93%	-17%	-22%	-33%	15%	41%
グライнда		37%	-28%	-3%	39%	43%	-30%	33%	3%

検収ベース

■ 構成比

	FY2020				FY2021			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本	18%	16%	13%	10%	14%	12%	12%	11%
アメリカ	6%	6%	7%	9%	7%	7%	5%	8%
アジア	71%	71%	73%	75%	73%	76%	76%	76%
シンガポール	9%	7%	8%	10%	8%	12%	10%	12%
台湾	20%	23%	19%	18%	15%	19%	17%	18%
韓国	12%	10%	11%	10%	12%	7%	7%	9%
中国 ※	29%	27%	34%	35%	35%	37%	41%	35%
その他	1%	4%	2%	2%	2%	1%	2%	1%
ヨーロッパ	4%	7%	8%	7%	6%	4%	6%	6%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※外資メーカー現地工場向け含む